

Title (en)

Process and device for applying liquid, pasty or plastic substances to a substrate.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Auftragen von flüssigen, pastösen oder plastischen Substanzen auf ein Substrat.

Title (fr)

Procédé et dispositif pour appliquer des substances liquides, pâteuses ou plastiques sur un substrat.

Publication

EP 0384278 A2 19900829 (DE)

Application

EP 90102857 A 19900214

Priority

DE 3905342 A 19890222

Abstract (en)

In a process for applying liquid, pasty or plastic substances, in particular thermoplasts, to a substrate, the substance is melted on, heated and applied to the substrate through an opening gap of a perforated cylinder, the substrate then being lifted off the cylinder. In this process, it is provided that the cylinder (3) is connected to an energy source (17) and is constructed itself as a heat source for the substance. <IMAGE>

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zum Auftragen von flüssigen, pastösen oder plastischen Substanzen, insbesondere Thermoplasten, auf ein Substrat (1), wird die Substanz aufgeschmolzen, beheizt und durch einen Mündungsspalt (7) eines perforierten Zylinders (3) auf das Substrat (1) aufgebracht, wobei das Substrat dann vom Zylinder (3) abgehoben wird. Dabei ist vorgesehen, daß der Zylinder (3) an eine Energiequelle (17) angeschlossen und selbst als Wärmequelle für die Substanz ausgebildet wird.

IPC 1-7

B05C 1/10; **B05C 5/04**; **B41F 15/08**; **D06B 23/02**

IPC 8 full level

B05C 1/00 (2006.01); **B05C 1/10** (2006.01); **B05C 5/00** (2006.01); **B05C 5/02** (2006.01); **B05C 5/04** (2006.01); **B41F 15/08** (2006.01); **D06B 23/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B05C 1/003 (2013.01 - EP US); **B05C 1/10** (2013.01 - EP US); **B05C 5/001** (2013.01 - EP US); **B05C 5/0258** (2013.01 - EP US); **B41F 15/0836** (2013.01 - EP US)

Cited by

WO0181007A1; US6805905B2; WO0181085A1; EP1181987A2

Designated contracting state (EPC)

CH DE ES FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0384278 A2 19900829; **EP 0384278 A3 19911204**; **EP 0384278 B1 19941214**; DE 3905342 A1 19900823; DE 59007967 D1 19950126; US 5122219 A 19920616

DOCDB simple family (application)

EP 90102857 A 19900214; DE 3905342 A 19890222; DE 59007967 T 19900214; US 47821390 A 19900209